

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION

部件名称 Product Name	X710_F2_PCIE
供应商 Vendor	芯智普
供应商料号 Vendor PN	
规 格 Specification	参见正文
最终判定 Final Approval	1、该部件规格经双方确认无误，达成一致，自双方签字或盖章之日起生效。 2、该部件的规格认定以此规格书为准。

供应商 Vender	客户 Customer
名称：珠海芯智普微电子有限公司 地址：珠海市横琴石山村73号第四层 电话： 邮箱： 法定代表人（或授权）：	名称： 地址： 电话： 邮箱： 法定代表人（或授权）：

产品技术规格书

技术规格书名称			
版本号	2.0	拟制日期	2023-09-21

一、变更记录

规格书版本	EC 编号	变更内容	修改者	变更日期

二、正文：

1、部件厂商型号及厂商物料版本

厂商型号	厂商物料版本
X710_F2_PCIE	NA

2、产品具体规格内容

产品型号	X710_F2_PCIE
控制芯片	Intel X710-BM2
板型	PCI-Express add-in card
总线类型	PCIe x8
网线接口类型	SFP+
网口传输速率	10/1 Gb/s
I/O Port	SFP+*2
总线速率	PCIE v3.0 8 GT/sec
连接器	PCIE_X8 金手指
输入电压	Voltage: 12V, 3V3_AUX, 3V3
网络标准	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
远程唤醒功能	不支持
智能卸载	是

Firmware version/ PXE Version	FW: V 9.40 MAP18.48 PXE: V 1.1.44
LED	Left---Activity LED: 绿色(无数据时绿色常亮,有数据时闪烁) Right---Speed LED: 1G 不亮 10G 绿色
操作系统支持	Windows10/8.1/8 Windows Server2019/2016/2012/2008/2003 Linux
其它技术参数	集成于芯片内的服务质量 (QoS) 和流量管理、多 CPU 负载平衡、TCP 校验和卸载、TCP 分段/大型发送卸载、虚拟机设备队列(VMDq)、PCI-SIG* SR-IOV 功能支持
功能特点	支持 iSCSI, PXE 引导, VLAN 汇聚
PCB 物理数据	长宽 148.79*68.5mm 挡片 Have bracket (高铁条档片&矮铁条挡片)
工作温度	0°C to 45°C
工作湿度	0%-85%, non-condensing
储存温度	-20°C to 75°C
无铅工艺	RoHS-R6

3、外观简图

3.1 正面图

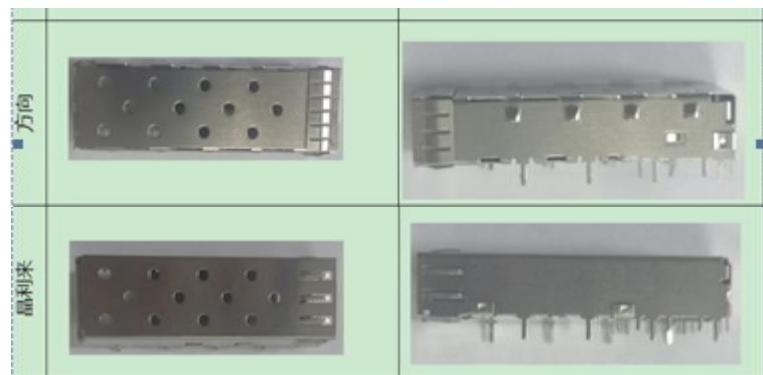
方案一：



备注：矽力杰电源方案

方案二：

备注：MPS 电源方案

3.1.1、光面笼子有以下两种（已经导入 202012）：

3.2 反面图

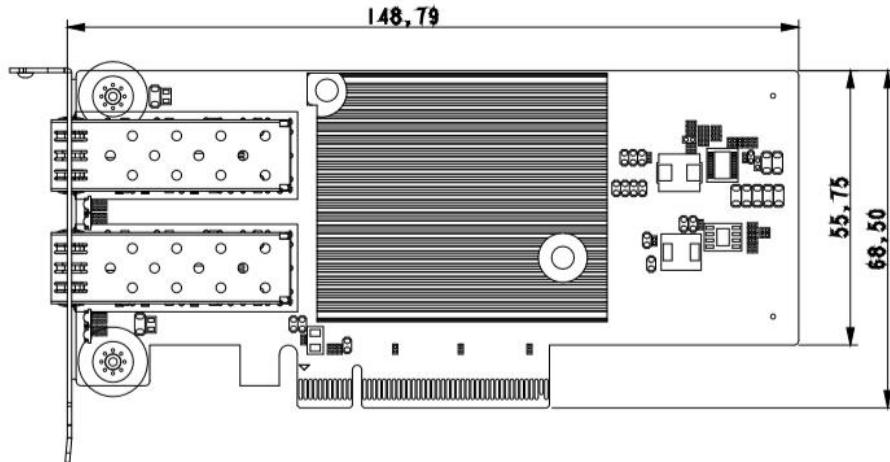
方案一：

备注：矽力杰电源方案

方案二：

备注：MPS 电源方案

3.3 2D 图



4、相关认证

(1) 所有材料 (及材料处理) 的构成符合 RoHS 环保认证的要求。



ROHS符合性声明
书.pdf

5、关于物料的变更

若产品需要进行更新或改进时，我司会至少提前两周以书面形式通知客户，同时需要提供本产品更新或改进所必须得技术资料/认证资料/测试验证报告等，至少体现以下内容：

- (1) a、对哪个元器件进行哪方面得改动/更新；
b、改动/更新的原因；
c、改动/更新的效果是否达到其目的，是否有不良影响。
- (2) 涉及电气特性变化的变更，需要提供相关测试通过的报告。

6、产品包装。

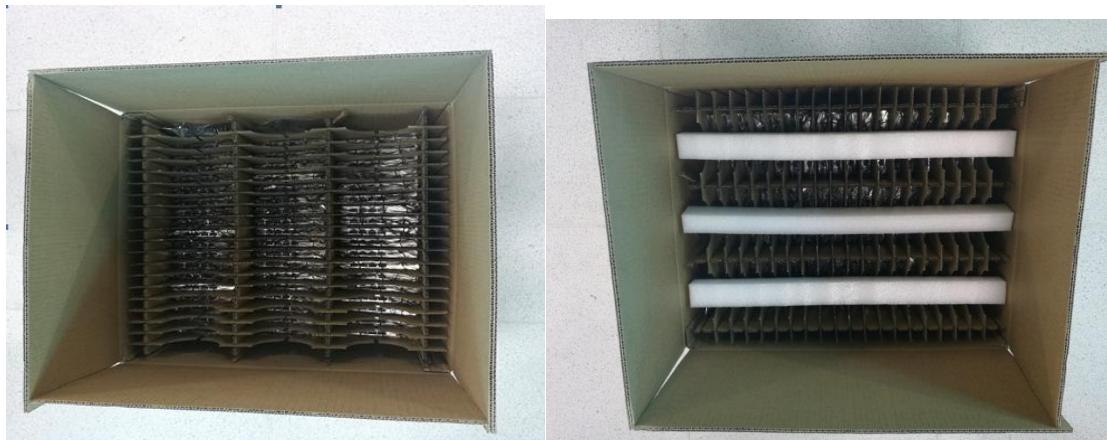
(1) 外箱尺寸：555x440x240mm

(2) 包装图示：

a: 网卡装入静电袋。



b: 放入蜂巢式包装箱，一个包装箱可以放入网卡54PCS，加泡沫棉。



c: 完成后进行封箱，箱体侧面会加上标签信息。



(3) 标签格式如下：

物料名称:	X710_F2_PCIE
规格描述:	XXXXXXXX
客户料号:	XXXXXXXX
客户订单号:	XXXXXXXX
箱号:	XX
数量:	54 PCS
备注:	